

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

胜宏科技(惠州)股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	广发证券、国金证券、国联民生证券、天风证券、新华资产、大成基金、富国基金、华商基金、平安基金、泰康资产、易方达基金、长城基金、长江养老、国泰基金、海富通基金、交银施罗德基金、平安养老、上海姚泾河私募基金、国投瑞银基金、宏利基金、摩根士丹利基金、民生加银基金、诺安基金、泉果基金、融通基金、天弘基金、银河基金、南方基金、浙江益恒投资、中信证券、德邦基金、诺德基金、长盛基金、上海合远私募基金、泰康资产、Marshall Wace、柏骏资产、博裕资本、上善如是基金、北京真科基金、景顺长城、中欧瑞博、胤胜资产、凯丰投资、敦和资管、领湾投资、宝盈基金、博时基金、财通证券、上海趣时、景鸿永泰、信达汉石、鹏嘉资产、上海高毅资产、首钢基金、工银理财、迪策投资等108位机构投资者。
时间	2025年10月13日-2025年10月17日
地点	惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技（惠州）股份有限公司、深圳、北京
上市公司接待人员姓名	1、董事长：陈涛 2、董事、总裁：赵启祥 3、财务总监：朱国强 4、副总裁、董事会秘书：朱溪瑶 5、证券事务代表：周响来 6、投资者关系经理：王慧珍

投资者关系活动主要内容介绍	一、投资者参观公司展厅、生产车间 二、互动交流环节具体情况如下： 1、目前公司的订单怎么样，生产状况如何？ 答：目前公司在手订单充足，业务进展顺利，生产环节围绕订单需求进行科学排产，产能利用率维持在良好水平，订单生产和交付均在正常履行中。 2、泰国工厂的生产经营及扩产进度到什么阶段了？ 答：公司泰国工厂 A1 栋一期升级改造已于今年 3 月完成，已开始投产，二期升级改造也已基本收尾。二期改造完成后，厂房将具备生产高多层和高阶 HDI 产品的能力，近期北美科技大客户已经在陆续审厂，此外也有部分客户开始针对泰国工厂进行产品导入，部分订单已经开始排期。泰国 A2 栋厂房的建设也正在按计划有序推进中。 3、公司在东南亚的布局和生产效率、供应链成本是否具备竞争优势？ 答：公司将充分发挥总部的人才、技术、品质、客户等优势全方面赋能海外生产基地，实现海内外基地间的强大协同及海外生产基地的高效运营，比如公司通过总部调遣部分核心管理及技术人员参与海外生产基地建设运营、各基地使用集中化的生产系统支持等。 以泰国工厂为例，泰国工厂今年 3 月已完成一期升级改造，二期高端产能的升级改造也即将进入尾声，今年下半年盈利能力有望明显提升。中长期来看，伴随产线优化、自动化升级和管理优化，未来泰国工厂的盈利能力有望与总部水平相当。
----------------------	--

	4、公司在 HDI 方面投入大量资源，使公司成为全球极少数能够大规模生产 6 阶及更高阶数 HDI 的公司之一，请具体介绍公司在 HDI 领域取得以上成就的关键因素包括哪些？ 答：主要包括四个层面：1）技术方面，公司管理层前瞻性战略布局支持 AI 算力的高阶 HDI 技术，快速实现技术突破，使得公司高阶 HDI 产品满足支持算力的超大 BGA 设计及平整度要求，在厚板和大尺寸的设计上同时做到较小的线宽线距，并使用更高等级的高速材料，满足对损耗、阻抗等信号完整性的要求等，这些技术突破为公司在 AI 算力领域确立领先优势奠定深厚基础；2）设备方面，大规模生产高品质的高阶 HDI 产品需要行业最顶尖的设备。公司投入大量资金采购行业内顶级设备，构建了行业领先的智能化生产线，能够实现很好的制程能力和稳定性；3）制造方面，高阶 HDI 的生产制造非常复杂，工序繁多，并且在制造过程中不同设备的协同配合、稳定运行都需要深厚的制造经验积累。公司通过多年的制造积累，探索出独特的管理制造流程，将智能制造、人工智能技术深度赋能制造流程，能够更好地管控生产流程、实现行业领先的产品品质；4）人员方面，我们的首席技术官 Victor J. Taveras 先生具有 PCB 行业资深背景，对材料原理和技术拥有很深的造诣，尤擅高频高速材料评估、电镀药水管控、对准度管控等，深谙高可靠性、高多层板和高阶 HDI 产品的技术研发和工艺管控，在交换机、服务器、光通信等应用领域享有盛誉。CTO 带领团队不断突破下一代 HDI 技术，工程师团队具备丰富的经验和处理复杂问题的能力，一线员工具备良好的素质和稳定性。
--	---

	5、公司的高阶 HDI 产品拥有较大的竞争优势，那么在高多层 PCB 领域，公司主要有哪些优势？主要应用场景有哪些？ 回复：公司在高多层 PCB 领域的优势包括：1）领先的技术优势，公司目前已具备 70 层以上高多层 PCB 的研发与量产能力，拥有 100 层以上高多层 PCB 的技术研发储备。公司的 10.0mm 厚板技术实现了 40:1 的高纵横比，能够有效适配超大尺寸芯片的封装，同时公司正在研发 14.5mm 的超厚板技术。公司的高精度背钻技术在量产中已达到 4±2mil 的精度，显著降低信号损耗。此外，公司正在积极研发 0-stub 工艺，为满足下一代超高速信号传输要求；2）领先的产能优势，公司是全球最大的高多层 PCB 生产基地之一，具备承接多样化产品大规模量产的能力，为持续深化客户合作奠定坚实基础；3）全球化交付、高质量服务优势，公司在泰国和马来西亚均设有研发生产基地，也正进一步加快泰国、越南高端产能的扩产建设速度。公司将进一步构建面向全球客户的敏捷交付与配套服务网络，满足全球头部客户在 AI 服务器、汽车电子及智能驾驶系统等领域产品的海外交付需求。 高多层 PCB 产品主要应用于 AI 服务器的主板、电源管理、散热模组等场景，包括数据中心交换机、网络通信设备（如 5G 基站、光通信设备）、工业控制设备（如伺服系统）等下游领域。 6、公司新增产能全部投产后，主要面向哪些下游客户需求？公司预计下游客户是否有充足需求消化新增产能？ 答：公司新增产能主要面向 AI 算力、AI 服务器等领
--	--

	域。PCB 行业当前的景气度有其坚实的需求基础，随着全球通用人工智能技术加速演进，人工智能训练和推理需求持续扩大，AI 算力、AI 服务器的需求迅速增长，对 PCB 的需求量大且要求高，为行业未来的持续增长提供了强有力的支撑。 从发展趋势来看，信号传输带宽将持续升级，材料等级不断提高，高多层板、高阶 HDI 的层数、阶数不断增加，这会进一步消耗高端产能，有效产出面积（平米数）呈减少趋势。当然随之而来的是公司产品价值量、产值能力在不断提升。从中期来看，高端产品的供给仍将处于相对紧张的状态，下游有充足的需求消化新增产能。 PCB 属于高度定制化的产品，要基于明确的订单需求及未来技术方向才能更精准更有效地扩产，公司目前的产能规划主要基于下游客户需求和订单情况的预测。公司在服务好大客户的同时，也在持续推进与其他全球头部科技企业的合作，提前进行技术储备与高端产能的准备。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025年10月17日